承認日　2025年10月31日
認証記号 R221031N03DPFS117

認証書付属書（異板厚）

表１　認証試験板厚の溶接条件データ
（最小及び最大ルート間隔の場合）

梁ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（mm） × 通しﾀﾞｲｱﾌﾗﾑ板厚（mm） 表面段差（mm）		最小、最大ﾙｰﾄ間隔（mm）	溶接電流範囲（A）	溶接電圧範囲（V）	溶接速度範囲（ｃｐｍ）	パス数
１２×１９	３．０	４～１０テーパ	270～310	31～38	22～29	3
		１０	280～300	31～38	19～20	
３２×４５	９．０	４～１０テーパ	270～320	31～38	22～32	11
		１０	270～320	31～39	20～28	

定常状態の溶接条件データ測定値を記載している。

表２　認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲（表面段差 ≦ 2.0mm）

梁ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（mm）	表面段差（mm）	最小 ６mm、最大ﾙｰﾄ間隔（mm）	溶接電流範囲（A）	溶接電圧範囲（V）	溶接速度範囲（ｃｐｍ）	パス数
９	２．０以下	４	230～350	25～39	20～45	3
		６	230～350	25～39	15～35	
		１０	230～350	25～39	15～30	
１２	２．０以下	４	230～350	25～39	20～45	3
		６	230～350	25～39	15～35	
		１０	230～350	25～39	15～30	
１６	２．０以下	４	230～360	25～40	20～55	4
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
１９	２．０以下	４	230～360	25～40	20～55	5
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２２	２．０以下	４	230～360	25～40	20～55	6
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２５	２．０以下	４	230～360	25～40	20～55	8
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２８	２．０以下	４	230～360	25～40	20～55	9
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
３２	２．０以下	４	230～360	25～40	20～55	11
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
３６	２．０以下	４	230～360	25～40	20～55	13
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
４０	２．０以下	４	230～360	25～40	20～55	15
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	

パス数は、表１および表２に記載の１０％増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。

※　この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 350℃以下、YGW18：パス間温度350℃以下)で使用しなければならない。

※　裏当て金とダイアフラムのかかりは4.0mmを標準とする。

※　鉄骨システムソフトウェア Ver 8.5 以降

表３　認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲（2.0mm ＜ 表面段差 ≦ 5.0mm）

梁ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（mm）	表面段差（mm）	最小 ６mm、最大ﾙｰﾄ間隔（mm）	溶接電流範囲（A）	溶接電圧範囲（V）	溶接速度範囲（ｃｐm）	パス数
９	３．０以下	４	230～350	25～39	20～45	３
		６	230～350	25～39	15～35	
		１０	230～350	25～39	15～30	
１２	３．０以下	４	230～350	25～39	20～45	４
		６	230～350	25～39	15～35	
		１０	230～350	25～39	15～30	
１６	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	５
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
１９	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	５
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２２	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	７
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２５	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	８
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２８	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１０
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
３２	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１２
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
３６	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１４
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
４０	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１６
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	

パス数は、表１および表２に記載の１０％増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。

※　この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 350℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。

※　裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。

※　鉄骨システムソフトウェア Ver 8.5 以降

表４　認証試験時データから想定された溶接施工条件範囲（5.0mm ＜ 表面段差）

梁ﾌﾗﾝｼﾞ板厚（mm）	表面段差（mm）	最小 ６mm、最大ﾙｰﾄ間隔（mm）	溶接電流範囲（A）	溶接電圧範囲（V）	溶接速度範囲（ｃｐm）	パス数
９	３．０以下	４	230～350	25～39	20～45	３
		６	230～350	25～39	15～35	
		１０	230～350	25～39	15～30	
１２	３．０以下	４	230～350	25～39	20～45	４
		６	230～350	25～39	15～35	
		１０	230～350	25～39	15～30	
１６	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	５
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
１９	５．０以下	４	230～360	25～40	20～55	５
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２２	６．０以下	４	230～360	25～40	20～55	８
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２５	７．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１０
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
２８	８．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１０
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
３２	９．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１２
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
３６	１０．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１５
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	
４０	１１．０以下	４	230～360	25～40	20～55	１７
		６	230～360	25～40	15～50	
		１０	230～360	25～40	15～40	

パス数は、表１および表２に記載の１０％増までのパス数を認める（小数点以下は切上げ）。

※　この溶接施工条件範囲は、認証証に記載された溶接条件(40kJ/cm 以下、YGW11：パス間温度 350℃以下、YGW18：パス間温度 350℃以下)で使用しなければならない。

※　裏当て金とダイアフラムのかかりは 4.0mm を標準とする。

※　鉄骨システムソフトウェア Ver 8.5 以降